

## ●WLP-4-02 パッケージ許容損失

WLP-4-02 パッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

### 1. 測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pb フリーはんだ

実装基盤：基板 40mm×40mm（片面 1600mm<sup>2</sup>）に対して

銅箔面積

1 層目：約 50%\_各リード接続

2 層目：約 50%\_各リード接続

3 層目：約 50%\_各リード接続

4 層目：約 50%\_各リード接続

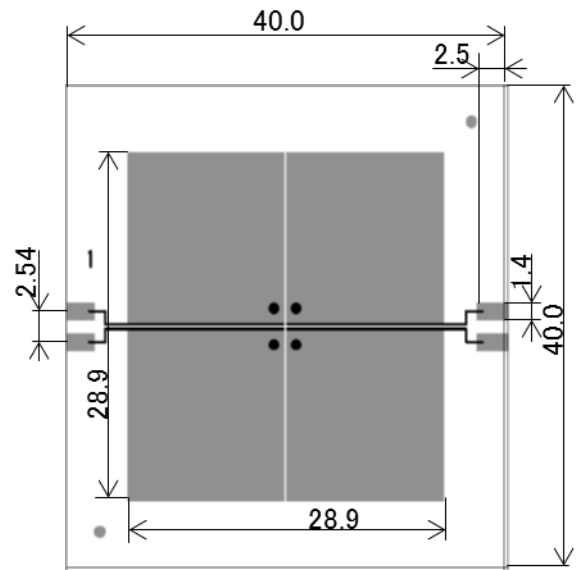
放熱板と周りの銅箔接続

基板材質：ガラスエポキシ（FR-4）

板厚：1.6mm

スルーホール：ホール径 0.8mm 4 個

銅箔厚：18um



評価基板レイアウト(単位:mm)

### 2. 許容損失-周囲温度特性

基板実装( Tjmax=125°C)

周囲温度(°C)	許容損失 Pd(mW)			$\theta_a(^{\circ}\text{C}/\text{W})$
	Ta max=85°C	Ta max=105°C	Ta max=125°C	
25	660	660	660	151.52
85	264	264	264	
105	0	132	132	
125	0	0	0	

